

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

武汉帝尔激光科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名 称	国新证券；华鑫证券；开源证券；国盛证券；华泰证券；东北证券；西部证券；国泰海通证券；东方财富证券；财通证券；国信证券；国元证券；华西证券；中泰证券；中国国际金融；长江证券；兴业证券；华福证券自营；光大证券；中信证券；中银国际证券；方正证券；中国银河证券；瑞银证券；招商证券；天风证券；国海证券；国金证券；广发证券；国联民生证券；博时基金；华泰保兴基金；华安基金；天治基金；泰信基金；创金合信基金；诺安基金；尚正基金；东方基金；西部利得基金；中信保诚基金；弘尚资管；前海再保险；大家资管；长桥证券；美银证券；摩根士丹利亚洲；长江证券经纪(香港)有限公司；IGWT 投资；HardingLoevner；摩根士丹利投资；DymonAsia；碧云资管；群益证券；中信期货；陆家嘴信托；拓森投资；赢舟咨询；世嘉控股；莫尼塔咨询；麻王投资；杭州涨不停企管；申万宏源研究；米仓资产；富达利泰管理；汇正研究所；汇正财经；台州国资投资；智联私募；Decent Capital；申万宏源证券有限公司光谷营业部等 125 家机构及相关人员。
时间	2026 年 4 月 27 日 20:00-21:00
地点	线上电话会议、公司会议室。

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事、副总经理 段晓婷女士</p> <p>董事会秘书 乔端先生</p> <p>财务负责人 刘志波先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）在微纳级激光精密加工领域深耕多年，主营业务是激光精密微纳加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售，目前下游应用领域主要覆盖全应用场景下的光伏行业，是国内首次将激光技术导入光伏太阳能电池路线的国家高新技术企业。</p> <p>公司瞄准新基建带来的广阔市场机遇，以智能制造装备为主业，聚焦光伏及作为智算核心的信息基础设施的核心装备需求，积极布局“第二增长曲线”，持续研发先进封装、化合物半导体、新型显示等领域的激光加工设备，构建“光伏主营业务为基础、半导体业务为延伸、持续布局前瞻技术与产品、配套服务为支撑”的持续发展的业务体系。</p> <p>公司聚焦光伏电池及组件全流程加工需求，覆盖BC、TOPCon、HJT、钙钛矿、PERC等全系技术路线，是光伏龙头企业的核心设备供应商。公司在技术上持续创新，在TOPCon工艺上创新局部结、TCP、TCL、激光烧结等技术工艺，在BC工艺上除量产的激光微刻蚀和铜电镀技术外创新激光晶化技术，在组件技术上创新激光整版焊、背板互联技术，在HJT工艺上开发激光转印设备、激光烧结设备，在钙钛矿工艺上开发P1-P4技术。</p> <p>公司依托超快激光技术积累，在半导体先进封装等领域上持续取得进展。公司已经完成面板级玻璃基板通孔设备出货，实现了晶圆级和面板级TGV封装激光技术的全面覆盖，客户已提出复购需求。针对PCB电子级树脂基新型功能复合材料在超高速应用场景下的应用需求，公司与多家头部企业合作，迅速推进PCB超快激光精密加工设备研发项目，目前已经完成材料验证工作，即将交付客户进行量产验证。</p>

公司在化合物半导体、新型显示的激光微纳加工领域进行了前瞻性研发及业务布局。

一、经营方面

公司2026年第一季度完成营业收入4.23亿元，同比下降24.68%，实现净利润1.64亿元，同比增长0.33%，2026年一季度经营活动产生的现金流量净额2.41亿元，同比上升233.54%。

2026年第一季度，公司研发支出0.52亿元，同比减少17.21%，占收入比重12.20%，同比减少了1.10%，主要是公司持续保持研发强度，更加聚焦重点研发项目，优先保障新技术、新工艺开发工作，增强技术创新能力与产品竞争力。

截至2026年3月31日，公司存货14.78亿元，较年初的15.69亿元，减少了5.82%；公司合同负债12.23亿元，较年初的14.13亿元，下降了13.44%。合同负债体现了未验收的执行中合同从客户收取款项的金额，变化与光伏行业整体情况一致。

截至2026年3月31日，公司资产负债率39.49%，较上年末的41.10%，下降了1.61个百分点，主要为合同负债减少所致，整体而言，公司的长短期偿债能力是非常稳健的。

二、投资者互动主要内容

1.2026年Q1经营活动产生的现金流量净额较年初增加的原因？

答：2026年Q1经营活动产生的现金流量净额2.41亿元，同比上升233.54%，主要原因是公司因收到货款、银行承兑汇票到期兑付及支付款项减少，使得报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，且购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2.公司港股招股书中提及募集资金用于激光、先进封装、化合物半导体及新型显示等领域的目标企业并购，目前是否有相关收购目标？后续收并购标的的选择思路是什么？

答：公司目前没有明确的并购标的，如有将及时披露。收并购是公司未来方向之一，合作形式也不限于收并购，也可能包括专利合作等多种形式。公司会综合考量标的与公司产业链的契合程度及协同效应。

3.公司PCB业务布局、进展。

答：PCB市场应用空间广阔，公司在超快固体激光技术应用方面有深厚的技术积累，基于前期在光伏电池打孔技术的应用、TGV微孔技术的持续研发，结合PCB行业对高密度多层板的需求，公司开启了PCB行业超快激光技术的应用开发，主要方向为超快激光钻孔技术的开发，持续推动技术的延伸和应用拓展。公司已与多家客户进行对接，目前，超快激光钻孔设备样机试制中，有多家客户正在公司打样。

4.公司TGV设备进展。

答：TGV激光微孔设备是通过精密控制系统及激光改质技术，实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工，提升基板的电气性能和热性能，为后续的金属化工工艺实现提供条件。公司TGV微孔设备已实现晶圆级和面板级出货，该技术也可应用于先进封装、RDL、CPO、新型显示等行业，在2026年已有小批量复购订单。

5.展望2026年BC市场趋势。

答：预计未来几年BC产能将持续增长，短期新增产能受行业政策等多方因素影响，2026年BC预计有40-50GW的新增/改扩产需求。

6.公司一季报收入下滑，但是利润未下滑的原因。

答：2026年一季度公司收到的政府补助和税收返还较上年同期增加所致。

7.公司采购的超快激光器是否有遇到供货紧张的问题。

答：公司光学器件有部分进口，主要来源于欧洲、美洲、亚洲等地区，可选供应商较多。同时，公司与国内供应商保持交流合作。

	<p>8.目前PCB超快激光设备打样阶段，核心关注的指标有哪些？</p> <p>答：打样阶段核心关注的指标包括：打孔品质与精度，避免出现不一致的输出及底层损伤，确保打孔精度符合要求，以及保证后续电镀工艺的匹配性与可靠性。</p> <p>公司交流人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单 (如有)	无。
日期	2026年4月27日